



第59期 報告書

2016年4月1日 ▶ 2017年3月31日

Shinkawa

新川 株式会社

証券コード：6274

大いなる飛躍に向け、中期経営計画「Challenge Shinkawa2020」を達成し、業界トップグループへの振り返りを目指します!!



代表取締役社長執行役員 長野 高志

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、温かいご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに第59期報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

2016年度（2017年3月期）の連結業績は、売上高16,438百万円（前期比29.8%増）、営業利益294百万円、経常利益432百万円、親会社株主に帰属する当期純利益243百万円となりました。

世界経済は、米国、欧州の底堅い内需に支えられ、回復基調を維持しました。一方で、中国を始めとする新興国経済の減速に加え、欧米諸国の政策に対する不確実性の高まりから、先行き不透明感の残る状況が続きました。

エレクトロニクス業界においては、IoTの普及に伴い、ワイヤレス通信の高速化に向けた投資が継続したことに加え、車載向けおよびディスクリット市場での設備投資が好調に推移しました。一方で、スマートフォンの大容量化やサーバーのSSD化を背景に、NANDフラッシュの旺盛な需要があったものの、ウェーハ不足から、メモリーメーカー各社の設備投資は限定的となりました。

このような状況のもと、当社グループは、市場を絞った販売戦略を実行することで、ワイヤボンダUTC-5000シリーズ、メモリ用ダイボンダSPA-1000および小チップ用ダイボンダSTC-800が売上高に大きく貢献しました。

また、長きにわたり赤字を計上し、株主の皆様にはご心配をおかけしておりましたが、これまで種々の収益構造改革を強力に推進してきた結果、漸く黒字転換を果たすことができました。

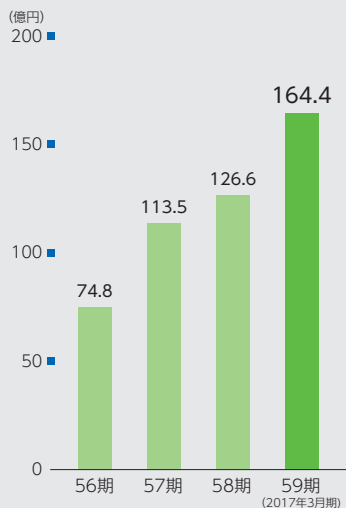
しかしながら、配当につきましては、当期の業績、財務状況および今後の積極的な成長投資の実施を総合的に勘案した結果、内部留保の充実を優先し、誠に遺憾ながら無配とすることといたしました。株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、可能な限り早期の復配を目指してまいります。

当社グループは、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）分野が半導体市場の新たな牽引役として期待されるなか、半導体市場の新時代到来を見据え、2020年度（2021年3月期）を最終年度とする中期経営計画「Challenge Shinkawa 2020」を策定しました。ボンディング技術のリーディングカンパニーを目指し、常に実装技術の革新に挑戦することで、持続的成長を図ってまいります。

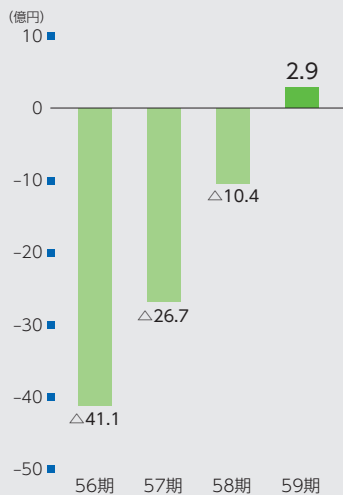
株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご理解、ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

連結財務ハイライト

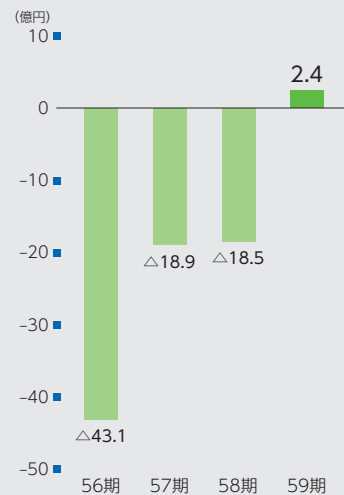
■ 売上高



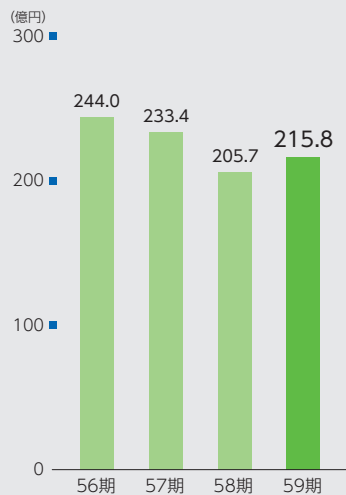
■ 営業利益



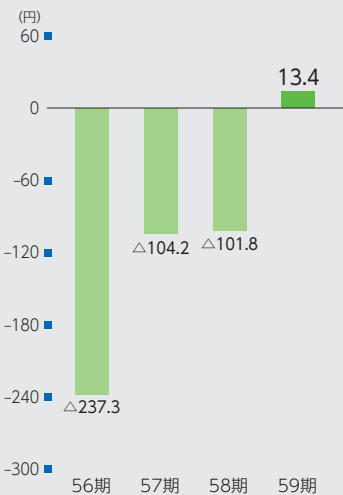
■ 親会社株主に帰属する当期純利益



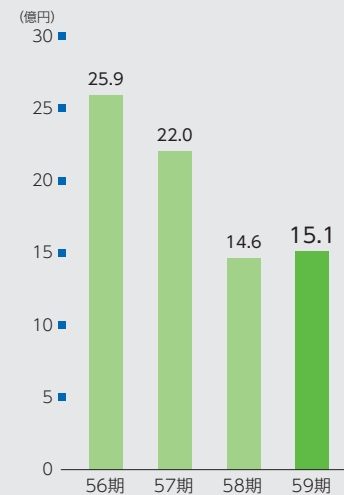
■ 純資産



■ 1株当たり当期純利益

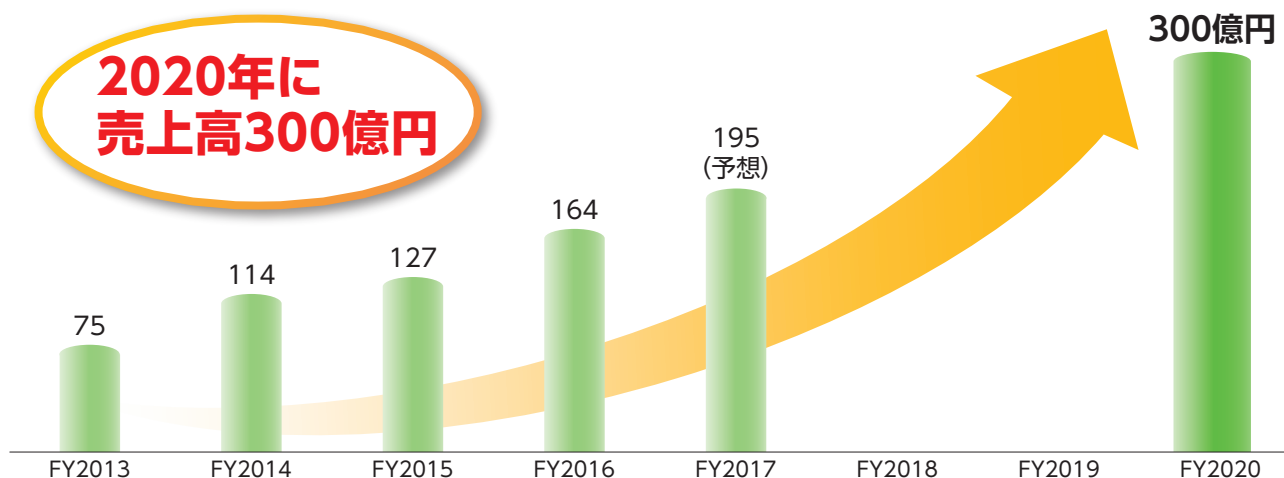


■ 研究開発費

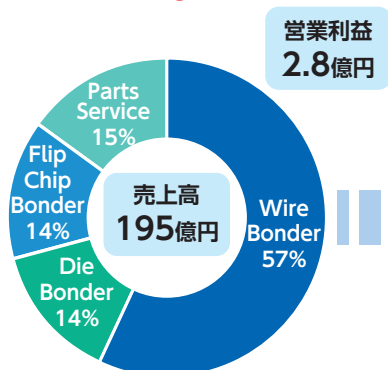


Challenge Shinkawa 2020

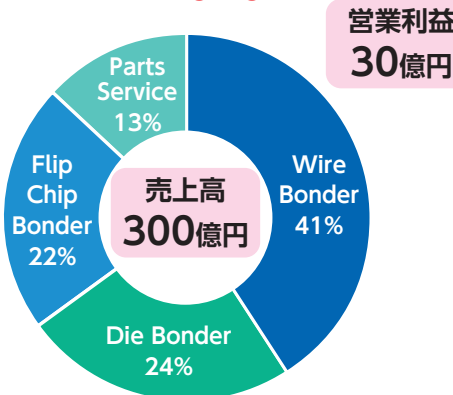
新川は、ボンディング技術のリーディングカンパニーを目指し、常に実装技術の革新に挑戦します



FY2017



FY2020



最終年度ROEは、**10%レベルを目指します**

～ステークホルダー還元の方へ～
 当社グループは、顧客の生産現場で進行するIoTによるイノベーションに対応する新製品の開発や新たなソリューションの創造など、成長のための投資（設備投資、R&D、M&A）を積極的に行うことで、永続的かつ安定的な利益還元を目指します。

基本戦略

1. 既存事業の成長

IoT時代の到来を受け、半導体パッケージへの要求には様々な変化が見られます。データストレージのSSD化やメモリの高速化に対応すべく、引き続きワイヤボンダ、ダイボンダの機能強化を進めるとともに、メモリキューブや先端CPUに使われる3次元/2.5次元実装に向け、Thermal Compression Bondingなどの最先端実装工法に対応したフリップチップボンダの開発および拡販を推進します。

また、スマートフォンなどの通信機器の高機能化にともない、PoP (Package on Package) やFO-WLP (Fan Out-Wafer Level Package) などの高機能パッケージの需要が拡大しつつあり、これらに対応したフリップチップボンダの機能強化も進めています。

2. 新しいビジネス価値の開発

Shinkawa Smart Bonding Solutionのコンセプトのもと、半導体組立工程にIoT機能を取り込んだソリューションの開発を進めています。装置のインテリジェント化 (センシング機能の強化)、ネットワークのインテリジェント化 (データ収集・解析機能の強化)、プロセスのインテリジェント化 (ノウハウのソフト化) を推進し、IoT社会の進展に伴って発生する課題に先んじてソリューションを提案することで、顧客満足と企業価値の向上を図ります。

3. 組織活性化と人材育成

創造性を発揮する組織へと変革するため、多様な人材の確保が必要となります。世界各国の優秀な人材が活躍するステージを提供するとともに、意識改革をはじめとした人材育成に注力しています。

ESGへの取り組み

E nvironment

- ・製品のライフサイクル (中古事業、リファービッシュ事業の拡大)
- ・製品の使用によるCO₂排出量削減 (消費電力が少ない)
- ・生産におけるCO₂排出量削減
- ・環境配慮型製品・サービスの開発

S ociety

- ・顧客への対応 (顧客サポート)
- ・安全衛生に関する取り組み
- ・ワーク・ライフ・バランス
- ・海外サプライヤーの労働環境への取り組み
- ・地域社会への貢献活動
- ・ダイバーシティへの取り組み

G overnance

- ・コーポレートガバナンス、内部統制
- ・グローバルマネジメントシステム
- ・役員報酬・インセンティブ
- ・取締役会の構成
- ・コンプライアンス徹底
- ・リスクマネジメント、潜在的リスクの見える化活動
- ・事業継続計画 (BCP)
- ・情報セキュリティ

1

「ウェーハ用ワイドエリア対応高速バンプボンダSBB-5200を市場投入」

来るIoT時代では、あらゆるモノにセンサーが搭載され、その数は1兆個になると見込まれています。当社グループは、各種センサーに組み込まれる、RFデバイス、水晶デバイス、MEMSなどの電子部品生産向けとして、ウェーハ用ワイドエリア対応高速バンプボンダSBB-5200を開発しました。同機種は、ワイヤボンダUTC-5000をベースとしており、高速バンプボンディング（30ms/バンプ）の実現に加え、2ウェーハステージ仕様と昇降温制御機能を搭載することでウェーハ交換時間を短縮し、生産性向上に貢献します。



2

「マルチプロセス対応パッケージボンダFPB-1ws NeoForceを市場投入」

FPBシリーズは、ハイエンドデバイス向けThermal compression bonding工法の課題であった生産性を大幅（2.4倍/装置：当社比）に向上させるとともに、

C2、C4、FO-WLP等の各種工法に対応したパッケージボンダです。昨年、シリーズの第一弾として、基板へのチップ搭載プロセス（Chip to Substrate：C2S）に特化したFPB-1s NeoForceを市場投入しました。

近年、最先端メモリ・ロジック生産において、ウェーハにチップを搭載するプロセス（Chip to Wafer：C2W）による3次元/2.5次元実装が開始されており、先端実装装置に対するウェーハ対応への要求が急速に高まっています。FPB-1ws NeoForceは、高生産性を維持しながら、市場の変化に合わせてC2W・C2Sの選択を可能とし、お客様のビジネス拡大に貢献します。

同時に、C2Wに特化した「FPB-1w NeoForce」をFPBシリーズのラインナップに加えることで、IoT時代の到来によるプロセスの多様化にフレキシブルに対応していきます。



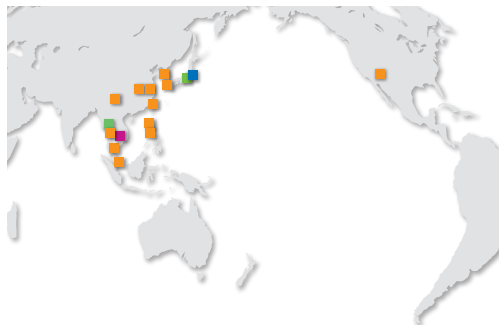
会社概要

会社概要

商号	株式会社新川		
本社設立	東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1 1959年8月6日		
資本金	83億6,000万円		
従業員数	株式会社新川	285名	(2017年3月31日現在)
	新川グループ	712名	(2017年3月31日現在)
事業内容	半導体製造装置の研究・開発・設計・製造・販売 および保守サービス		
役員	代表取締役社長執行役員	長野 高志	
(2017年6月29日現在)	取締役専務執行役員	永田 憲雅	
	取締役常務執行役員	森 琢也	
	取締役執行役員	藤野 昇	
	取締役	安生 一郎	
	取締役	川上 雄一	
	執行役員	田島 寛敏	
	執行役員	佐久間 哲也	
	執行役員	大岡 文彦	
	執行役員	李 豪成	
	常勤監査役	宗像 広志	
	監査役	関口 晃嗣	
	監査役	吉野 正己	
	監査役	三矢 麻理子	
取引金融機関	東京都民銀行三鷹支店 三菱東京UFJ銀行立川支店 みずほ銀行立川支店		

グローバルネットワーク

■ 本社 ■ 開発／製造／販売 ■ ソフトウェア開発 ■ 販売／保守サービス



株式の状況 (2017年3月31日現在)

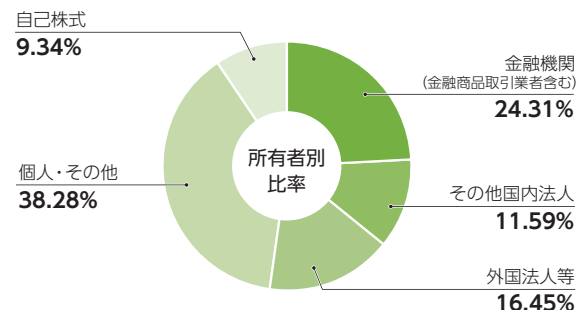
発行可能株式総数	80,000,000株
発行済株式の総数	20,047,500株
株主数	7,946名

大株主の状況

氏名又は名称	所有株式数 (千株)	比率 (%)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1,067	5.32
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 東京都民銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	900	4.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	710	3.54
新川取引先持株会	535	2.67
株式会社アイ・アンド・イー	499	2.49
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019	432	2.15
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	409	2.04
東京TYリース株式会社	405	2.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	320	1.59
株式会社三菱東京UFJ銀行	293	1.46

(注) 1. 所有株式数、比率とも表示単位未満を切り捨てて表示しています。
2. 当社の保有する自己株式1,873千株は上記の表には含めていません。

所有者別株式数比率



株主メモ

事業年度	毎年4月1日～翌年3月31日
定時株主総会	毎年6月
株主確定基準日	定時株主総会 議決権行使株主 3月31日 配当金受領株主 3月31日 なお、中間配当を行う時は9月30日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告する一定の日
公告方法	電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.shinkawa.com
1単元の株式の数	100株
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-711 (通話料無料)
上場証券取引所	東京証券取引所

ご注意

- 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっています。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に登録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっていますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にでもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。



この冊子は環境にやさしい植物油インクと再生紙を使用しています。

当社ウェブサイトのご案内

当社ウェブサイト上で会社概要、財務内容をはじめ業務内容詳細ならびにプレスリリース内容等をタイムリーかつ幅広くお知らせしています。

<http://www.shinkawa.com>



Shinkawa
株式会社 新川

〒208-8585 東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1
TEL. 042-560-1231 FAX. 042-560-8485